

3EC-M1S-VLP

- ・ 7 μ m と薄い銅箔ですが、高抗張力のため、キャリア無しでの供給が可能です。
Thin foil (7 μ m), high tensile strenght, supply without carrier foil.
- ・ ロープロファイル電解銅箔であり、サブトラでのファインパターン形成に最適です。
Low profile copper foil, suitable for fine etching in the subtractive process.

用途/Application

- ・ フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

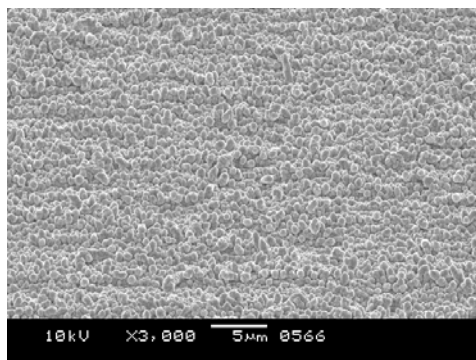
- ・ 日本/Japan

代表的特性値/Representive date

	μ m	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elogation (%)	Peel Strength (kg/cm) ^{@FR-4}
3EC-M1S-VLP	7	64	1.8	500	4	0.7

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

